

お客様のものづくりに対し 信頼ある分析でお付き合いします



ガスクロマトグラフィー質量分析



オージェ電子分光分析



赤外分光分析



走査電子顕微鏡

Elemental

元素・分離技術

ppbオーダーから主成分までの
定性・定量分析

- 薄膜の組成及び不純物分析
- 腐食生成物の定性、定量
- 半導体材料中の不純物分析
- 鉄鋼、非鉄金属、セラミックス等の主成分及び微量成分の定量
- フラックス中のハロゲン、アルカリ成分の定量
- めっき液、エッチング液中の各種イオンの定量
- 半導体ウエハの汚染物分析
- 油中ハロゲン及び有機酸(イオン)の定量
- 樹脂中の不純物分析
- 高分子材料の分子量分布測定
- 有機材料の元素分析(C, H, N, O)

Composition

組成・構造解析

有機物の化学構造及び
無機物の結晶構造の解析

- ラミネートフィルムの層構造の解析
- 金属表面の防食被膜・防錆剤等の膜解析
- 樹脂、ゴム、接着剤、塗料等の有機化合物の同定
- 有機化合物中の添加剤の同定
- 製品、部品に付着した微小異物の同定
- 薄膜の結晶配向解析
- 結晶方位、結晶格子サイズの解析
- 格子定数の精密測定
- 無機化合物の同定

Surface

表面・局所分析

深さ数十Å～数μmの
表面・局所分析

- 半導体プロセスの微小異物の同定
- 金属材料等の微小領域の定量
- 多層薄膜の層構造と界面状態の解析
- ウエハ中不純物の深さ方向濃度分布解析
- 表面付着物、析出物の二次元分布状態の解析
- 金属表面酸化物、化合物の化学結合状態分析
- 有機物の表面改質層の評価
- 腐食生成物の分布状態の解析
- 表面酸化物等の薄膜の膜厚測定

分析業務内容

最先端テクノロジーが
ここに結集

Shape

形態観察

数十倍から百万倍までの
顕微鏡観察

- 半導体デバイスにおける微小部の形状観察
- 多層薄膜断面の層構造観察
- 粉体、焼結体等の粒子形状、粒径等の観察
- めっき膜の膜厚測定
- Si及び化合物半導体の結晶構造解析
- 結晶粒径の測定
- 破面観察による破損原因の解析
- 金属、セラミックス等の結晶欠陥の解析
- 加工部品の加工面の表面粗さ測定



収束イオンビーム装置



X線光電子分光分析

